

5352131-1 ✓ AKTIV

Z-PACK | Z-PACK 2mm HM

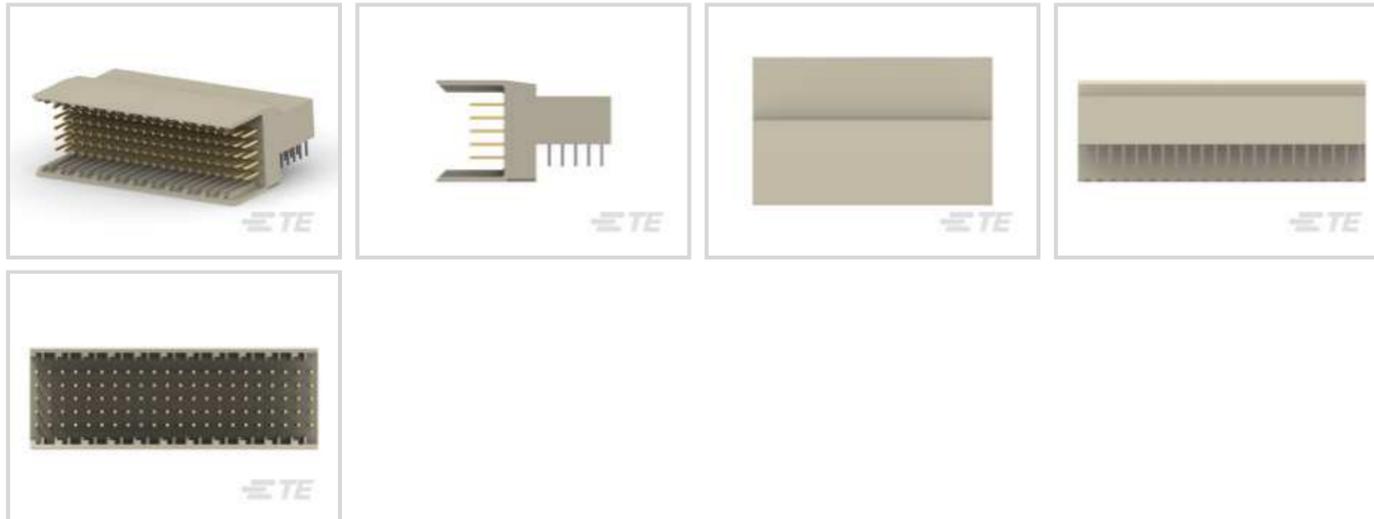
Interne TE-Nummer 5352131-1

Z-PACK 2mm HM, Hard Metric Backplane Connectors, PCB Mount Header,  $\leq 1$  Gb/s, 22 Column, 5 Row, Mezzanine, Board-to-Board, 110 Position

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Backplane-Steckverbinder > Harte metrische Steckverbinder



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**

Datenrate:  $\leq 1$  Gb/s

Spaltenanzahl: **22**

Zeilenanzahl: **5**

Backplane-Architektur: **Mezzanine**

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Backplane-Schnittstellentyp	2 mm HM
PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

### Konfigurationsmerkmale

Steck- & Trennkonfiguration	Voreilender Kontakt
Anzahl der Signalpositionen	110
Spaltenanzahl	22
Zeilenanzahl	5
Backplane-Architektur	Mezzanine
Anzahl von Positionen	110
Montageausrichtung für Leiterplatte	Rechter Winkel

### Signalmerkmale

Übersprechversion	Standard
-------------------	----------

Datenrate	≤1 Gb/s
-----------	---------

#### Kontaktmerkmale

Durchführungspostenlänge	3.3 mm
--------------------------	--------

Kontakttyp	Stift
------------	-------

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
---	--------

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
---	------

Kontaktmaterial	Phosphorbronze
-----------------	----------------

CompactPCI-Bezeichnung	Keine
------------------------	-------

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
--	------

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	1.27 µm[50 µin]
---	-----------------

Kontakt-nennstrom (max.)	1.5 A
--------------------------	-------

#### Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage – Press-Fit
-------------------------------------	-------------------------------

#### Montage und Anschlussstechnik

Fordere Steckebene	Ebene 1
--------------------	---------

Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage
--------------------------------	----------------------

#### Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Polyester – GF
-----------------	----------------

Raster	2 mm[.078 in]
--------	---------------

Gehäusefarbe	Grau
--------------	------

#### Abmessungen

Backplane Modullänge	44 mm
----------------------	-------

#### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
---------------------------	----------------------------

#### Betrieb/Anwendung

Geschirmt	Nein
-----------	------

Stromkreis Anwendung	Strom und Signale
----------------------	-------------------

#### Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

AdvancedTCA-spezifiziertes Produkt	Nein
------------------------------------	------

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	11
Verpackungsmethode	Tube

### Weitere

Kommentar	Warnung: Die Stecker der Kartenextender sollten nur mit Kabelsteckverbindern verwendet werden.
-----------	--

### Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUN 2020 (209) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUN 2018 (191) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### Kompatible Teile



TE Teilenummer 5188836-1  
Z-PACK/B22 RAF 110P



TE Teilenummer 122561-1  
SUPPORT ANVIL 2MM H.M. 7 ROW

## Auch serienmäßig | Z-PACK 2mm HM



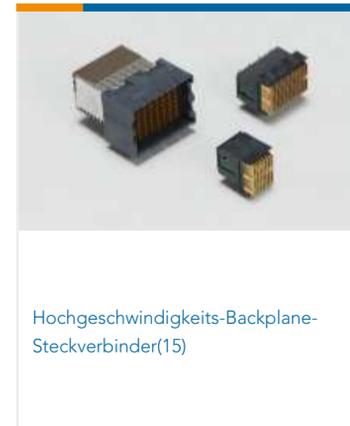
Abdeckungen für Leiterplatten-  
Steckverbinder(4)



Anschlusswannen für Leiterplatten-  
Steckverbinder(42)



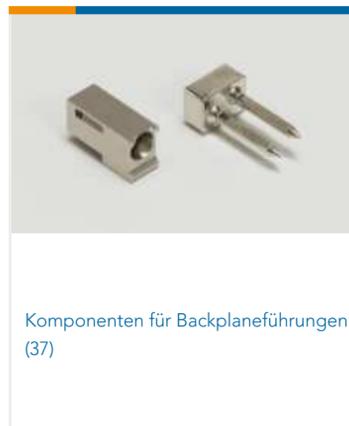
Harte metrische Backplane-  
Steckverbinder(254)



Hochgeschwindigkeits-Backplane-  
Steckverbinder(15)



Kodierstücke für Backplanes(60)



Komponenten für Backplaneführungen  
(37)



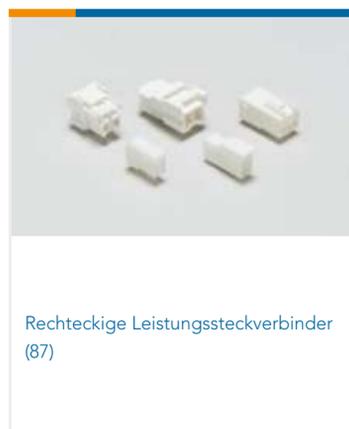
Laschen, Verriegelungen und  
Arretierungen für Leiterplatten(1)



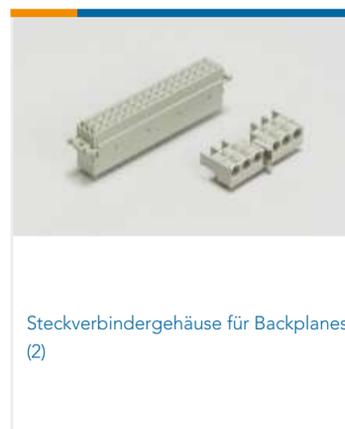
Leiterplatte-an-Leiterplatte-  
Steckverbinderkontakte(5)



Leiterplattenhülsen und -  
abschirmungen(19)



Rechteckige Leistungssteckverbinder  
(87)



Steckverbindergehäuse für Backplanes  
(2)

## Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenummer 6469081-1  
HMZD 3PR, RECEPTACLE ASSEMBLY



TE Teilenummer 5352406-1  
Z-PACK/B RAMH. 95P.



TE Teilenummer 1-1469492-2  
MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 45  
DEG



TE Teilenummer 5352152-1  
Z-PACK/B22 RAF 110P



TE Teilenummer1-6450869-4  
V/R 2ACP+1LP+32S+3HDP+1LP+1P



TE Teilenummer5106015-1  
Z-PACK/A RAMH.110P



TE Teilenummer1410142-1  
MULTIGIG RT T2 .8" BP FULL RGH



TE Teilenummer1-1469491-3  
MULTIGIG RT GUIDE PIN, 9MM 4.20



TE Teilenummer2110819-1  
QSFP+ Enh EVERCLEAR PT Conn



TE Teilenummer6469183-1  
HMZD 3PR RA HDR 60P ASSY LF

## Dokumente

### Produktzeichnungen

#### Z-PACK/B RAMH.110P.

Englisch

### CAD-Dateien

#### 3D PDF

3D

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5352131-1\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5352131-1\\_A.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5352131-1\\_A.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

### Produktspezifikationen

#### Anwendungsspezifikation

Englisch

### Umweltverträglichkeit von Produkten

#### MD\_5352131-1\_09172011937

Englisch

[MD\\_5352131-1\\_09172011937](#)

Englisch

5352131-1

Z-PACK 2mm HM, Hard Metric Backplane Connectors, PCB Mount Header,  $\leq 1$  Gb/s,  
22 Column, 5 Row, Mezzanine, Board-to-Board, 110 Position

